

# 第 179 回ラドテック研究会講演会

期 日：2023 年 4 月 27 日（木）13：00～16：40

会 場：東京理科大学神楽坂キャンパス 1 号館 17 階 記念講堂

主 催：一般社団法人ラドテック研究会

協 賛：一般社団法人近畿化学協会・一般社団法人色材協会・合成樹脂工業協会  
一般社団法人日本接着学会・一般社団法人日本塗装技術協会  
一般社団法人有機エレクトロニクス材料研究会・フォトポリマー懇話会  
日本放射線化学会（予定、順不同）

<プログラム>

（敬称略）

1) 13：00～13：50（質疑応答含む）

「自然環境に在るエネルギー変換系と高分子ゾル-ゲル設計」

北陸先端科学技術大学 桶菫 興資

水の蒸発界面は **DRY** で **WET** な非平衡環境であり、ミクロにもマクロにも高分子が組織化して  
くる。本研究では、水の相転移や水の分解に関わるエネルギー変換に着目し、特に界面分割現象  
を紹介する。

2) 13：50～14：40（質疑応答含む）

「光反応とヘテロエピタキシャル接合で構築される特異なナノ構造を持つプラズモニ  
ック光触媒」

近畿大学 納谷 真一

半導体ナノ粒子による光触媒反応を利用することで、原子レベルで整合したヘテロエピタキシ  
ヤル接合により特異なナノ構造体が構築され、極めて活性の高いプラズモニック光触媒が合成  
されることを紹介する。

14：40～15：00 休憩

3) 15：00～15：50（質疑応答含む）

「パッケージの高付加価値化に寄与する **EB** トップコート」

東洋インキ株式会社 大野 隆基

軟包業界で求められる短納期対応やプラスチック問題に対し、軟包装用に開発した **EB** トップコ  
ート「**Elex-one® Gloss Varnish**」が秘めたポテンシャルを紹介する。

「パッケージの高付加価値化に寄与する **E B** 硬化システム」

岩崎電気株式会社 坂寄 忠之

軟包業界の課題である短納期対応やプラスチック問題などの解決が求められている。その課題  
解決に向けて無溶剤、非加熱である **E B** コーティングラインの詳細及び **E B** 硬化装置の原理と  
構造を紹介する。

4) 15：50～16：40（質疑応答含む）

「改質・劣化による材料表面の強度変化を精密に分析」

株式会社パルメソ 松原 亨

材料表面をナノレベルでの強さ分布を可視化・数値化する **MSE** 試験を開発した。これまで材料  
自体の強さ比較や、多層構造の膜の強さ分布、表面劣化や改質などの強さ変化の様相などを対象  
に実績を積み重ねている。本講演では原理及び具体的試験事例、加えて光関係の表面改質や劣化  
についても紹介する。

※プログラムは変更になる場合がございます。